宁波华翔电子股份有限公司

关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华糊电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月6日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")下发的《关于宁波华糊电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函

[2025]120047号)(以下简称"《问询函》"),公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实,按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复,并对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行 了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所

事核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况、按照相关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风景

宁波华翔电子股份有限公司董事会

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-110

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告

东述或者重大遗漏,并对

元) ト扣保点細占上市公司最近一期经审计净资产 外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% 外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% 合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计常 ||风险提示(如有请勾选) 其他风险提示(如有) — 扫保情况概述

一、但环间75m22(一)担保的基本情况 (一)担保的基本情况 或于11.山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")与中国光大银行股份有限公司济 南分行签署了《最高额保证合同》,由公司对金源(山东)新能源科技发展有限公司(以下简称"金源科 技")在该行于2023年11月26日至2026年11月25日期间内发生的债务提供连带责任保证担保、提供 的担保金额为1,000万元。金源科技对本次担保不提供反担保。

公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十五次会议、2024年12月26日召开2024年第四次 临时股东大会,均审议通过了《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》;于2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议、2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会,均审 议通过了《关于调增公司公区主席综合。融资额度及担保额度的议案》。具体内容详见公司于025年 12月10日、2025年10月30日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2025年度申请综合 融资额度及担保额度的公告》(公告编号:2024-078)和《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于调 增2025年度综合融资额度及担保额度的公告》(公告编号: 2025-096)。截至本公告披露日、公司本年度对外担保情况均为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保,均在经公司股东会审议通过的授权担保额度范围内,无需另行召开董事会审议。 、被担保人基本情况

(一) 基本情况 担保人类型 5年人类型及上市公司持股情况 东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道庐山北路28号 2000万人民工 予費売用 要财务指标(万元)

、担保协议的主要内容

保证人:山东金帝精密机械科技股份有限公司 债权人:中国光大银行股份有限公司济南分行

2、担保方式:连带责任保证

2.13年入分注。在市场日本标记 3.担保金额:1,000万元人民币 4.保证期间:《综合授信协议为项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业 务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协 议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期

的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。 5.保证范围 受信人在《综合授信协议》项下应向投信人悠远或支付的债务本金。利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、 律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项。

五、董事会意见

五、董事会意见
本次担保事项在2024年12月9日召开第三届董事会第十五次会议、2024年12月26日召开2024年第四次临时股东会会2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议、2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会授权范围内,无需另行召开董事会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日之。可及其乾股子公司对外担保总额为175,500.00万元、公司对控股子公司提供的担保总额168,000.00万元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例为81.52%、78.03%。公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为1,500.00万元,主要系公司及子公司基于自身融资等需要,委托外部法人或其他组织提供保证责任,并由公司及子公司为其实指定的法人裁批任知程则。截至本公告披露日公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形、公司无逾期对外担保情况。除为公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反担保外,公司未对其他外部第三方提供担保

第三方提供担保。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-111

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于开展票据池业务的进展公告 陈述或者重大遗漏,并对

甘内穷的百字性 准确性和完整性承扣注律责任

表四各印刷来注:《韩明庄和无验庄开自应计自口。 一、本次实理超池业务基本情况 近日,山东金帝精密机械和柱股份有限公司(以下简称"公司")与兴业银行股份有限公司聊城分 行(以下简称"兴业银行")签署了《票据池业务合作协议》和《最高额质押合同》,根据兴业银行服务能 力及公司业务需求、确定兴业银行票据池额度为3.4亿元、未超过董事会及股东会审议额度、在上述额

度及有效期内,可循环使用。

二、内部决策程序 公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第二十次会议、2025年11月17日召开2025年第三 公司1205年10月27日日17年-四里華安和一〇公本人。 次临时股东会,均审议通过了《关于公司开展票据他业务的议案》。根据公司业务发展需要,提高公司 流动资产的使用效率,公司及控股子公司(含实施期限内新设立、收购的控股子公司)拟与合作银行开 展票据池业务,共享不超过人民币十六亿元的票据池额度,实施期限为自2025年第三次临时股东会 按索玛德思亚尔,央子小型以入内。川丁八亿九时,宗绪他领援,头施州院为自2025年第二次临时放叛结束,可议通过之日起12个月内有效。具体内容等股公司于2025年10月30日在上海证券交易所预除(www.sse.com.en)上披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告》(公告

编号:2025-094)。 、协议的主要内容

1.协议签署人 甲方:兴业银行股份有限公司聊城分行 乙方:山东金帝精密机械科技股份有限公司 2.协议有效期 2025年11月25日至2026年11月25日

3、票据池额度

票据池额度为3.4亿元 四、必要性和合理性

票据池额度为3.4亿元 四.必要性和合理性 随着公司业务规模的扩大,公司在收取销售款时有一部分是以票据方式,同时,与供应商合作也 经常采用票据的方式结算。公司开展票据池业务能极于地罐决以下方面的不利因素: 1.收到商业汇票后,公司可以通过票据池业务等应收票据统一产人协议银行进行集中管理,由银 行代为办理保管,托收等业务,可以减少公司对商业汇票管理的成本; 2.公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票,用于 向合作银行贷款,贸易融资。票据处现、开具商业汇票本贷、保函等,有利于减少货币资金占用,提高流 动资产的使用效率,实现股东权益的最大化; 3.开展票据池业务,可以将公司的应收票据和特开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化 批各结构,提款资金利服。对照等据的信息化等理。

财务结构,提高资金利用率,实现票据的信息化管理,

单位	:万元				
序号	票据池协议方	有效期起	有效期止	票据池额度	
1	兴业银行股份有限公司聊城分行	2025/11/25	2026/11/25	34,000.00	
	34,000.00				
	00.00				

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 2025年11月27日

上海硅产业集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:上海硅产业集团股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:沪硅产业

股票代码:688126 信息披露义务人:国家集成电路产业投资基金股份有限公司

住所及通讯地址:北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层718室 股权变动性质:持股比例下降(上市公司总股本增加导致信息披露义务人持股比例被动稀释) 国家集成电路产业投资基金股份有限公司

签署日期:2025年11月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相 关法律法规编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章 程或内部规则中的任何条款,或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第15号——权益变动报告书》的有关规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在上海硅产业集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或

减少其在上海硅产业集团股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或授权

任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本报告书中,除非文意另有原	行指,	下列简称具有如下特定含义:
上市公司、公司、沪硅产业	指	上海硅产业集团股份有限公司
信息披露义务人、产业投资基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
本次权益变动	指	上市公司因由特定対象发行股份、股权激励行权及发行股份购买资产事项导致总 股本增加、致使产业投资基金排股比例被动稀释。本次权益变动后,产业投资基金 持有上市公司股份数量为567,000,000股,占上市公司已发行股本总数的17.75%
报告书、本报告书	指	《上海硅产业集团股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍 、信息披露义务人的基本情况

截至本报告书签署日,产业投资基金的基本情况如下:

北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层718室 张新
PL-001
SICHIT
9,872,000万元人民币
911100007178440918
其他股份有限公司(非上市)
段权投资,投资咨询,项目投资及资产管理,企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展 经营活动。依法须经批准的项目,经相关前了批准师依比准的内容开展经营活动。不得从事本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2014年09月26日至2029年09月25日
北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层718室

序号	股东名称	出资比例
1	中华人民共和国财政部	36.4668%
2	国开金融有限责任公司	22.2853%
3	中国烟草总公司	11.1426%
4	北京亦庄国际投资发展有限公司	10.1297%
5	中国移动通信集团有限公司	5.0648%
6	上海国盛(集团)有限公司	5.0648%
7	武汉金融控股(集团)有限公司	5.0648%
8	中国电信集团有限公司	1.4182%
9	中国联合网络通信集团有限公司	1.4182%
10	武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司	0.5065%
11	中电金投控股有限公司	0.5065%
12	中电科投资控股有限公司	0.5065%
13	华芯投资管理有限责任公司	0.1216%
14	福建三安集团有限公司	0.1013%
15	北京紫光通信科技集团有限公司	0.1013%
16	上海武岳峰浦江股权投资合伙企业(有限合伙)	0.1013%

截至本报告书签署日,产业投资基金的董事及主要负责人基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
张新	男	董事长、总裁	中国	北京	否
唐雪峰	男	董事	中国	北京	否
严剑秋	男	董事	中国	北京	否
杨高峰	男	董事	中国	上海	否
程驰光	男	董事	中国	武汉	否
李国华	男	董事	中国	北京	否
秦斌	男	监事会主席	中国	北京	否
卢伟	男	监事	中国	北京	否
徐阳华	男	监事	中国	北京	否
高洪旺	男	监事	中国	北京	否
宋颖	女	职工监事	中国	北京	否
徐倩	女	职工监事	中国	北京	否
张春生	男	副总裁	中国	北京	否
黄登山	男	副总裁	中国	北京	否
韦俊	男	副总裁	中国	北京	否
杜丹	女	副总裁	中国	北京	否
张建华	男	副总裁	中国	北京	否

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司发行股份

截至本报告书签署日,除沪硅产业外,产业投资基金在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股

分达到或超过该公司发行	行股份5%的情况如下:	
序号	上市公司简称	特股比例
1	国微控股	9.23%
2	赛微电子	7.02%
3	安路科技	5.76%
4	中微公司	12.94%
5	通富微电	6.67%
6	华大九天	8.75%
7	芯原股份	6.61%
8	德邦科技	13.93%
9	燕东微	6.35%
10	中电港	7.37%
11	泰凌微	6.93%
12	盛科通信	15.00%
13	拓荆科技	19.67%
14	de#	26 400/

除上述持股情况外,产业投资基金不存在其他在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到 或超过该公司已发行股份5%以上(含5%)的情形。

第三节 本次权益变动目的

本次权益变动是由于上市公司向特定对象发行股份、股票期权激励计划行权以及发行股份购买 资产导致总股本增加,致使产业投资基金所持上市公司股份比例被动稀释减少。 、信息披露义务人未来12个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份计划

1、截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无在未来12个月内增持上市公司股份的计划安排。 若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义

2、根据上市公司于2025年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海硅产 业集团股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-068),国家集成电路产业投资基金股 分有限公司基于自身经营管理需要,计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过大宗交易 方式减持不超过54.943.543股上市公司股份,即不超过上市公司总股本的2%。在减持计划公告发布 日起至减持计划实施期间,上市公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、 除息事项,减持股份数量将进行相应调整。截至本报告书签署之日,该减持计划尚未完成。除上述已

披露的减持计划外,信息披露义务人尚无在未来12个月内减持上市公司股份的计划安排。若发生相 关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式 、本次权益变动方式

2022年3月3日,公司向特定对象发行股份,公司总股本由2,480,260,000股增加至2,720,298,399

股,产业投资基金持有公司股份比例由22.86%被动稀释至20.84%。 2022年7月6日,公司股票期权激励计划第二个行权期第一次行权,向激励对象定向发行股份,公

司总股本由 2,720,298,399 股增加至 2,731,658,657 股,产业投资基金持有公司股份比例由 20.84%被动 稀释至20.76%。 2023年8月22日,公司股票期权激励计划第三个行权期第一次行权,向激励对象定向发行股份,

公司总股本由2,731,658,657股增加至2,747,177,186股,产业投资基金持有公司股份比例由20.76%被 动稀释至20.64%。 2025年11月25日,公司发行股份购买资产,公司总股本由2,747,177,186股增加至3,194,582,680

股,产业投资基金持有公司股份比例由20.64%被动稀释至17.75%。 、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前后,信息披露义务人持有沪硅产业股份数量不变,持股比例由22.86%被动稀释

本次权益变动前后,信息披露义务人持有上市公司股份情况如下:

信息披露义务人							
旨思奴路又ガ八	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例			
产业投资基金 567,000,000 22.86%		22.86%	567,000,000	17.75%			
三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况							
华丕卡招生 北 紫栗市 停自抽屉 0.岁 1.桂左始沙社 5.北职 0.均头工图 4.岁 4.凌 3.职 7.左左左后							

权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。 第五节 前六个月内平去上市公司股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署日前6个月内,未通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股

截至本报告书签署日,除本报告书前文已披露事项外,产业投资基金不存在为避免对本报告书内 容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人

第七节 信息披露义务人声明 本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真

实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人:国家集成电路产业投资基金股份有限公司

法定代表人(张新): 2025年11月26日

第八节 备查文件 、备查文件目录

1、信息披露义务人的营业执照(复印件); 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件;

3、信息披露义务人签署的本报告书; 4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。 备查文件置备地点

本报告书及备查文件备置于沪硅产业住所

信息披露义务人:国家集成电路产业投资基金股份有限公司

简式权益变动报告书

	基本情况				
上市公司名称	上海硅产业集团股份有限公司	上市公司所在地	上海市		
股票简称	沪硅产业	股票代码	688126		
信息披露义务人名称	国家集成电路产业投资基金股份有 限公司	北京市北京经济技 开发区景园北街2 52幢7层718室			
拥有权益的股份数量变化	増加□ 減少√ 不变,但持股人发生変化□	有无一致行动人	有□ 无√		
信息披露义务人是否为上市公司第一 大股东	是√ 否□	信息披露义务人是否为上市公 司实际控制人	是□ 否✓		
权益变动方式(可多选)		○易□ 协议转让□ 国有股行致改 上市公司发行的新股□ 执行法 市公司总股本增加导致信息披露 释	完裁定□		
信息披露义务人披露前合计拥有权益 的股份数量及占上市公司已发行股份 比例	股票种卖:人民币普通股 持限效量:567,000,000股 持股比例:22.86%				
本次权益变动后信息披露义务人拥有 权益的股份数量及变动比例	股票种选,人民币普通股 变动效量;867,000,000股 变动比例;17.75%				
在上市公司中拥有权益的股份变动的 时间及方式		2022年3月至2025年11月 曾加导致信息披露义务人特股比例	削被动稀释		
是否已充分披露资金来源		是□ 否□ 不适用√			
信息披露义务人是否拟于未来12个月 内继续增持	截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无在未来12个月内增持上市公司股份的计划 排。 若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的规定及时履 信息披露义务。				
信息披露义务人在此前6个月是否在 二级市场买卖该上市公司股票	是□否✓				
涉及上市公司控股股	东或实际控制人减持股份的,信息披	露义务人还应当就以下内容予以	说明:		
控股股东或实际控制人减持时是否存	在侵害上市公司和股东权益的问题	是□ 否□ 不迫	5用√		
控股股东或实际控制人减持时是否存在 司为其负债提供的担保,或者		是□ 否□ 不适	5用√		
本次权益变动是	否需取得批准	是□ 否□ 不适用√			
显否已得	到批准	是□ 否□ 不证	€⊞√		

法定代表人(张新): 2025年11月26日

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2025-071

上海硅产业集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之发行结果 暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 发行数量和价格

1、股票种类:人民币普诵股(A PP)

2、发行数量:447,405,494股

3、发行价格:15.10元/股 ● 预计上市时间

本次发行股份购买资产的新增股份已于2025年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完成登记手续。

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易(预计上市时间如遇 法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日),限售期自股份发行完成之日起开始计算。 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。

. 本次发行概况

如无特别说明,本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日在上海证券交易所网站(http:// sse.com.cn)披露的《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。

一)发行履行的相关程序

1、本次交易方案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十九次会议审议通

2、本次交易方案已取得公司持股5%以上股东的原则性意见; 3、本次交易方案已经交易对方有权内部决策机构授权或批准; 4、本次交易方案已经标的公司董事会和股东会审议批准;

5、本次交易方案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过;

6、本次交易涉及的标的资产评估报告已经有权国有资产监督管理部门备案; 7、本次交易已经上交所审核通过:

8、本次交易已经中国证监会同意注册。 (二)本次发行情况

1、发行股份的种类、面值及上市地点 本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币

1.00元,上市地点为上交所。 2、定价基准日、定价原则及发行价格 本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份定价基准日为公司审议本次交易相关事项的

第二届董事会第二十六次会议决议公告日 经交易各方友好协商,本次发行股份及支付现金购买资产涉及的股份发行价格为15.01元/股,不 低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

自本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、 除息事项,发行价格将进行调整,计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下: 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为 该次每股派送现金股利,PI为调整后有效的发行价格。

本次发行股份购买资产采用向特定对象发行股份的方式,发行对象为海富半导体基金、产业基金 二期、上海闪芯、中建材新材料基金、上海国际投资、混改基金。 4、发行股份数量

资产的股份发行数量为447,405,494股,占本次发行股份购买资产完成后公司总股本的比例约为

根据标的资产的交易作价、本次发行股份购买资产的价格及股份支付的比例,本次发行股份购买

序号	交易对方	股份对价金额(元)	股份发行数量(股)
1	海富半导体基金	1,568,385,966.19	104,489,404
2	产业基金二期	3,407,017,543.86	226,983,180
3	上海闪芯	367,957,894.74	24,514,183
4	中建材新材料基金	699,819,512.20	46,623,551
5	上海国际投资	411,658,536.59	27,425,618
6	混改基金	260,717,073.17	17,369,558
合计		6,715,556,526.75	447,405,494

在本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、配股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项或根据前述发行价格调整机制调整发行价格,发行数量也将根据 发行价格的调整情况进行调整。 5. 股份锁定期

本次发行股份购买资产的交易对方因本次发行股份购买资产取得的公司新增股份自该等股份发 行结束之日起36个月内不得转让。 本次发行股份购买资产完成后,发行股份交易对方因本次发行股份购买资产取得的股份若由于

公司派息、送股、资本公积金转增股本、配股等原因增加的,所增加的股份亦应遵守上述股份锁定期的 若上述锁定期安排与证券监管机构的最新规定及监管意见不相符,本次发行股份购买资产的交

易对方同意根据证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整。 上述锁定期届满后,本次发行股份购买资产的交易对方转让和交易公司股份将依据届时有效的

法律法规和上交所的规则办理, (三)本次交易的实施情况

1. 标的资产计户情况 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局已于2025年10月20日核准新昇晶投本

次交易涉及的工商变更相关事项,并向新昇晶投换发了新的(常业执照)。 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局已于2025年10月21日核准新昇晶科本 次交易涉及的工商变更相关事项,并向新昇晶科换发了新的《营业执照》

中国(上海)自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局已于2025年11月20日核准新昇晶睿本 次交易涉及的工商变更相关事项,并向新昇晶睿换发了新的《营业执照》。 本次过户完成后,公司及其全资子公司上海新昇半导体科技有限公司持有新昇晶投100%股权,

公司以及新昇晶投持有新昇晶科100%股权,公司以及新昇晶科持有新昇晶睿100%股权

的方式合计持有标的公司100%股权。 2、验资情况 2025年11月20日,立信对公司本次发行股份及支付现金购买资产进行了验资,并出具了《上海硅 产业集团股份有限公司验资报告》(信会师报字(2025]第ZA15174号)(以下简称"《验资报告》")。根据《验资报告》,经审验、截至2025年11月20日,公司已收到海富半导体基金、产业基金二期、上海闪芯、

截至本公告披露日,本次交易涉及的标的资产的过户事宜已办理完毕,公司当前通过直接和间接

中建材新材料基金、上海国际投资、混改基金缴纳的新增注册资本人民币447,405,494,00元,变更后公 司的累计注册资本为人民币3,194,582,680,00元,股本为人民币3,194,582,680,00元。 3、新增股份登记情况 根据登记结算公司于2025年11月25日出具的《证券变更登记证明》,公司已办理完毕本次发行

股份购买资产的新增股份登记,新增股份447,405,494股,登记后股份总数3,194,582,680股。 截至本公告日,本次发行股份购买资产新增股份的验资及登记手续已办理完毕。

理完毕。

法定代表人(张新):

4、现金对价支付情况 截至本公告日,公司尚未完成对交易对方现金对价的支付。 (四)中介机构核查意见

1、独立财务顾问意见 "1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序,符合《公司法》《证券法》《重组管理 办法》等相关法律法规的要求。

2、截至本核查意见出具日,本次交易标的资产已过户至上市公司名下,上市公司已合法持有标的 公司股权,标的资产过户程序合法、有效。 3、截至本核查意见出具日,本次发行股份及支付现金购买资产新增股份的验资及登记手续已办

4、截至本核查意见出具日,本次交易实施过程中,未发现相关实际情况与此前披露的信息存在重 大差异的情况 5、截至本核查意见出具日,本次交易实施过程中,上市公司董事、高级管理人员不存在因本次交 易而发生更换的情况。标的公司存在董事、监事更换的情况,主要系考虑本次交易后标的公司股东变

6. 截至本核杏音用出具日,本次交易实施过程中及实施后,不存在上市公司资金,资产被持股5%

以上主要股东或其他关联人非经营性占用的情形,亦不存在上市公司为持股5%以上主要股东及其关 联人提供扣保的情形。 7、截至本核查意见出具日,本次交易各方已签署的各项协议及作出的相关承诺事项已切实履行 或正在履行, 未出现违反协议约定或承诺的行为。 8.在交易各方按照其签署的相关协议和做出的相关承诺完全履行各自义务的情况下, 本次交易

后续事项的实施不存在实质性法律障碍。"

2、法律顾问核查意见 本次交易的法律顾问嘉源认为

"1.本次重组方案的内容符合《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的规定。 2、本次重组已经取得现阶段必需的授权和批准,本次重组相关协议约定的生效条件已得到满足, 本次重组具各实施条件。

3、本次重组的标的资产已完成交割过户手续,公司已完成本次交易所涉新增注册资本的验资及 新增股份登记手续,实施情况合法有效。 4、截至本法律意见书出具之日,公司已就本次重组履行了相关信息披露义务,符合相关法律、法 规和规范性文件的要求;本次重组实施过程中未出现实际情况与此前披露信息存在重大差异的情形。 5、自公司取得中国证监会关于本次交易的注册批复后至本法律意见书出具之日,标的公司董事

监事因标的公司股东变化情况相应发生变动,标的公司高级管理人员不存在因本次交易而发生更换

6、截至本法律意见书出具之日,不存在上市公司资金、资产被持股5%以上主要股东或其他关联 人非经营性占用的情形,亦不存在上市公司为持股5%以上主要股东或其他关联人提供担保的情形。 7、截至本法律意见书出具之日,本次重组相关方不存在违反本次重组相关协议约定及其已披露

的承诺的情形 8、在本次重组各方切实履行相关协议及承诺的基础上,本次重组后续事项的实施不存在实质性

法律障碍。" 二、本次发行结果及发行对象简介

> (一)发行结果 本次发行股份购买资产的发股价格为15.01元/股,发行股份数量为447,405,494股。

(二)发行对象 本次发行股份购买资产采用向特定对象发行股份的方式,发行对象为海富半导体基金、产业基金 二期、上海闪芯、中建材新材料基金、上海国际投资、混改基金。 发行对象的具体情况详见公司于2025年9月27日于上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》之"第三节交易对方基本情况"之"一、发行股份及支

付现金购买资产交易对方"。 、本次发行前后上市公司前十名股东变动情况 (一)本次发行前上市公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	股份数量(股)	持股比例(%
1	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	567,000,000	20.64
2	上海国盛(集团)有限公司	546,000,000	19.87
3	上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	126,073,596	4.59
4	上海新阳半导体材料股份有限公司	110,455,692	4.02
5	上海新微科技集团有限公司	83,160,780	3.03
6	华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	72,011,521	2.62
7	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	62,476,953	2.27
8	中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数 证券投资基金	59,579,503	2.17
9	招商银行股份有限公司—华夏上证科创版 50成份交易型开放式指数证券投资基金	58,259,822	2.12
10	香港中央结算有限公司	38,853,966	1.41
	合计	1.723.871.833	62.75

(二)本次发行后上市公司前十名股东持股情况

本	次新增股份完成登记后(截至2025年11月25日),公司前十	一大股东持股情况如	下所示:
序号	股东名称	持股数量(股)	比例(%)
1	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	567,000,000	17.75
2	上海国盛(集团)有限公司	546,000,000	17.09
3	华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	298,994,701	9.36
4	上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	125,183,596	3.92
5	上海新阳半导体材料股份有限公司	108,135,692	3.38
6	海富产业投资基金管理有限公司—海富半导体创业投资(嘉兴)合伙企业(有限合伙)	104,489,404	3.27

每银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证 64,245,876 2.01 国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式: 证券投资基金 1.89 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有障

(三)本次发行对上市公司控制权的影响 本次交易前上市公司无控股股东、实际控制人。本次交易完成后,上市公司仍无控股股东、实际

274.717.72

控制人,本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。 四、本次发行前后上市公司股本结构变动表 裁至2025年9月30日 上市公司首股本为2747177186股 根据标的资产的交易作价 木炉发

行股份购买资产的价格及股份支付的比例,本次交易拟向交易对方发行447,405,494股。本次交易前 后(不考虑募集配套资金)上市公司股权结构变化情况如下 股东名称 持股数量(万股) 持股数量(万股) 持股比例 产业投资基金 56,700.00 20.64% 56,700.00 17.75% 19.87% 54,600.00 17.09% 国盛集团 54,600.00 产业基金二期 7,201.15 9.36% 2.62% 10,448.94 3.27% 海富半导体基金 4.662.36 1.46% 中建材新材料基金 上海国际投资 508.16 0.18% 3,250.72 1.02% 上海闪芯 2,451.42 0.77% 混改基金 0.54% 155,708.4 155,708.41 48.74%

上市公司发展起路。本次交易有利于进一步推升对称的公司的管理整合、发挥协同效应,提升经营管理效率。本次交易对上市公司的影响具体详见上市公司于2025年9月27日于上交所网站(www.sse. com.cn)披露的《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书》之"第一节本次交易概述"之"六、本次交易对上市公司的影响"。 六、本次发行相关中介机构情况 (一)独立财务顾问

100.00%

本次交易是上市公司战略发展的延伸,有利于巩固上市公司在半导体硅片行业的领先地位,符合

319.458.27

100.00%

名称

(四)评估机构

特此公告。

7、管理层讨论与分析

注册地址 建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28 电话 010-65051166 传真 010-65051166 康攀、孔亚迪、邵闳洋、翁嵩岗 项目主办人 陈曦、樊雨欣、田锦轩、谷皓影、刘家佑、冯枫烨、申雯林 (二)法律顾 名称 北京市嘉源律师事务所 负责人 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 注册地址 电话 傳扬远、张璇、陈热 (三)审计机构

公司董事会将根据相关文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权,在规定期限内办理 本次交易相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险

上海硅产业集团股份有限公司董事会

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2025-072

上海硅产业集团股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的 提示性公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 -、本次权益变动的基本情况 上海硅产业集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇品投半导体科技有 限公司、上海新昇晶科半导体科技有限公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权,并募集

本公司董事全及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载。涅导性陈述或者重大清温、并对

2025年9月26日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕2140号),具体内容详见公司于 2025年9月27日披露的《上海硅产业集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2025-066)。 本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行对象为海富半导体创业投资(嘉兴)合伙企业(有 限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海闪芯企业管理合伙企业(有限合伙)、中 建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海国际集团投资有限公司、中国国有企业混 会所有制改革基金有限公司。本次发行股份及支付现金临买资产涉及的发行股份完价基准日为公司

育议本次交易相关事项的第二届董事会第二十六次会议决议公告日。经交易各方友好协商,本次发

行股份及支付现金购买资产涉及的股份发行价格为15.01元/股。本次向交易对方发行股份数量的具 1,568,385,966.19 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公 226,983,180 3.407.017.543.86 上海闪芯企业管理合伙企业(有限合伙 367,957,894.74 24,514,183 中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙) 699,819,512.20 46,623,551 27,425,618 411,658,536.59

6,715,556,526.75

447,405,494

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况 本次交易前后,公司均无控股股东、实际控制人,本次交易不会导致公司控制权变更。 E、本次权益变动前后公司5%以上股东持股情况

本次交易前后(未考虑募集配套资金),上市公司5%以上股东持股情况如下表所示。 本次重组后(不考虑募集配套资金) 本次重组前 股东名称 2.62% 9.36% 72,011,521

本次交易完成后,交 股份的股东。国家集成	 			持有公司5%以
企业名称	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司			
企业类型	其他影	と份有限公司(す	上市)	
法定代表人	张新			
4年 コムと田佳町	011	100000110110	Van	

20.415.000万元

北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层701-6 目投资、股权投资;投资管理、企业管理;投资咨询。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集 金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定,本次公司权益变动相关信

息披露义务人已按规定履行信息披露义务,详见公司于2025年11月27日在上海证券交易所网站

com.cn)披露的相关公告

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年11月27日